

证券代码：688808

证券简称：联讯仪器

苏州联讯仪器股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026-002

投资者关系活动类别	☐ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☐ 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	线上参与公司 2026 年半年度业绩说明会的全体投资者
时间	2026 年 9 月 4 日 15:00-16:00
地点	价值在线（ https://www.ir-online.cn/ ）网络互动
上市公司接待人员姓名	董事长 胡海洋先生 副总经理、董事会秘书、财务负责人 廖金先生 独立董事 高玉标先生
投资者关系活动主要内容介绍	1.领导好，请问贵司的存货构成明细，原材料半成品和发出商品各占多少？以及在手订单对存货的覆盖周期是到 q3 还是覆盖到什么时候？关键物料具体是什么，囤货进度。谢谢 答:截至 2026 年 6 月 30 日，公司存货账面价值 11.51 亿元，其中原材料 3.53 亿，占比为 30.67%，在产品 1.73 亿，占比为 15.03%，发出商品 3.85 亿，占比为 33.45%，其余为库存商品、委托加工物资。整体结构和公司“以销定产”的模式是匹配的。存货增长快的核心原因是下游光通信、光芯片客户扩产节奏快，公司在手订单充足，公司依据在手订单情况进行了合理的备货。关键物料主要是高端测试仪器设备所需的电子元器件、专用芯片等，基于实际业务需要，公司做了适度提前备货，备货节奏跟随订单和供应链情况动态调节。 2.公司上半年业绩增长非常亮眼，营收、利润都大幅增长，核心驱动因素是什么？

	答:2026年上半年,公司实现营业收入15.31亿元,同比增长208.71%;实现归属于上市公司股东的净利润5.67亿元,同比增长903.00%。业绩大幅增长主要来自两方面:一是AI算力市场发展带动下游需求稳步增长,受益于人工智能技术发展及全球算力需求提升,数据中心建设进程加速,高速光通信产品需求持续高速增长,光模块、光芯片厂商扩产意愿强烈,拉动公司通信测试仪器及光电子器件测试设备市场需求快速增长;二是公司核心产品性能持续提升、获得境内外优质客户广泛认可,65GHz采样示波器等高技术附加值产品持续放量,推动产品结构向高价值化升级,进一步带动盈利水平提升。 3.上半年公司营收突破15亿元,同比实现两倍以上增长,想请廖总拆解一下,光通信测试、功率器件测试、半导体电性能测试这几条核心业务线,分别贡献了怎样的增长?当前哪条线的景气度最高? 答:公司2026年上半年实现营收15.31亿元、同比增长208.71%,归母净利润5.67亿元、同比增长903.00%。公司三条主线报告期内均实现良好增长:光互联领域,65GHz采样示波器、1.6Tbps误码分析仪等1.6T光模块测试核心产品已向多家国内外知名用户量产供货;功率器件领域,晶圆级老化系统、KGD分选测试系统持续规模化交付,导入东芝、博世、纳微等客户;半导体电性能领域,精密源表、WAT测试机订单及出货规模高速增长。从下游看,AI算力与数据中心建设对高速光通信的拉动最为直接。 4.胡总您好,半年报显示期末存货达到11.5亿元,较上年末增长近130%,请问这主要是对应下游旺盛需求的备货,还是在手订单交付节奏的安排?整体订单能见度目前到什么水平? 答:截至2026年6月末存货账面价值11.51亿元、较上年末增长129.85%,系下游需求旺盛、核心客户扩产加快,公司依托在手订单有序备货。公司采取“以销定产、适当备货”模式,期末合同负债6.49亿元、较上年末增长303.65%,在手订单较为充足。 5.上半年销售费用、管理费用的增速远低于营收增速,规模效应已经显现。想请教一下廖总,随着公司营收规模继续扩大,后续毛利率和费用率还有没有进一步优化的空间? 答:公司2026年上半年毛利率较为出色,主要得益于65GHz采样示波器等高附加值产品放量、结构向高价值化升级。费用端,销售费用增长17.95%、管理费用增长57.22%,均远低于营收208.71%的增速,规模摊薄效应显著;研发费用2.50亿元、增长83.34%,保持战略性高位。后续公司将继续优化成本
--	---

	结构与交付效率，规模效应有望继续摊薄销售和管理费用率。 6.胡总您好，我还有两个关于产品和海外市场的问题想请教：1、半年报提到高速存储芯片测试系统已通过国内头部 DRAM 厂商的 ETS 工程验证、自研 ASIC 和 PE 芯片流片成功，HBM 芯片 KGD 分选测试系统也在客户送样验证中。能否介绍一下这两款核心产品目前的具体进展，距离量产落地还有哪些关键节点？2、上半年公司境外收入占比达到 53.86%，首次超过半数，全球化成效非常显著。想请问海外市场的核心增长动力来自哪里？ 答:问题 1：高速存储芯片测试系统自研 ASIC、PE 芯片已流片成功，通过国内头部 DRAM 厂商 ETS 工程验证，目前正在整机验证，后续还需完成客户产线验证与量产导入；HBM 芯片 KGD 分选测试系统处于客户送样验证阶段，有序推进中。上述产品仍在研发验证或客户导入阶段，量产落地时间存在不确定性，公司目前不对其量产时间表和收入贡献作出预测。 问题 2：公司依靠突出的产品性能、交付效率和技术服务优势，在全球业务布局上取得了突出成就。公司全球化战略以境外销售业务为重心，从技术支持、售后服务以及供应链各方面全方位实现出海，大幅提升响应速度与本地化支持能力。公司于 2022 年进军日本市场，逐步实现产品出海并积累宝贵的在地化服务经验；2023 年以来，公司在东南亚地区相继设立新加坡办公室、马来西亚制造中心、泰国技术服务中心，在紧随国内头部客户出海步伐的同时，加快导入国际顶尖客户群体，努力提升本土化交付能力与服务水平；2025 年以来，在已经具备一定国际市场规模的基础上，公司于美国、韩国设立子公司，持续提升全球化交付能力。通过输出核心产品、技术与服务优势，公司全方位赋能境外市场，并聚焦国际头部用户需求不断进行技术创新与产品优化。 7.二季度是否延续了增长趋势？这种高增长的可持续性如何？ 答:2026 年第二季度公司实现营业收入 10.43 亿元、归母净利润 4.48 亿元，环比一季度分别增长约 114%和 277%，增长势头延续。从订单景气度看，报告期末公司合同负债 6.49 亿元、存货余额 11.51 亿元，较年初均大幅增长，主要原因是下游市场需求持续旺盛、核心客户产能扩张节奏加快，公司依托充足在手订单有序备货，订单能见度较好。从行业层面看，AI 算力需求有望保持增长态势，数据中心建设持续推进，高速光通信测试需求具备一定支撑；碳化硅功率器件产业化进程提速，也为
--	--

	功率器件测试设备带来增量空间。公司对全年经营保持信心，但具体业绩受行业波动及市场不确定性影响，请以公司定期报告披露为准。 8.公司经营现金流由负转正，主要原因是什么？ 答:2026年上半年公司经营活动产生的现金流量净额为 5.48 亿元，上年同期为-0.58 亿元，实现由负转正，主要系业务规模增长、盈利水平提升，销售回款形成的资金净流入显著增加。现金流净额高于净利润，反映公司销售回款效率较高、盈利具备扎实的现金支撑，经营质量良好。 9.光互联（光通信）业务上半年进展如何？ 答:公司是国内极少数覆盖光互联全产业链核心测试环节的企业。通信测试仪器方面，面向 1.6T 高速光模块测试需求的 65GHz 采样示波器、120GBaud 时钟恢复单元、1.6Tbps 误码分析仪、1.6Tbps 光模块测试仪等核心产品向多家国内外知名用户量产供货，市场份额持续扩大；高速线缆测试仪实现批量交付。光电子器件测试设备方面，CoC 光芯片老化测试系统、光芯片 KGD 分选测试系统、硅光晶圆测试系统等产品力与用户基础持续提升，向国际头部用户出货规模持续增长；面向 CPO/NPO OE 芯片裸 Die 级分选测试需求的 OE 芯片 KGD 分选测试系统已通过行业一流用户验证并实现收入。 10.公司综合毛利率大幅提升到 70%以上，主要原因是什么？这个水平能持续吗？ 答:2026年上半年公司综合毛利率为 70.79%，较 2025 年度的 58.84%提升明显，主要得益于 65GHz 采样示波器等高技术附加值产品持续放量、产品结构向高价值化升级。公司将持续通过技术创新和产品迭代巩固盈利能力，同时不断优化成本结构与交付效率。需要说明的是，毛利率受产品销售价格、成本波动、市场竞争及产品结构占比等多因素影响，未来可能出现一定波动，公司将持续关注并努力保持在合理较好水平。 11.公司上半年的盈利质量和费用管控情况如何？ 答:2026年上半年费用端，销售费用、管理费用随营收规模增长保持合理增速，规模摊薄效应显著；研发投入保持战略性高位，报告期内研发费用 2.50 亿元，同比增长 83.34%。扣除股份支付影响后的净利润为 5.89 亿元，同比增长 654.97%，盈利质量较高。 12.半导体电性能业务（精密源表、WAT 测试机）进展？ 答:在半导体电性能领域，公司提供精密源表、WAT 测试机等产品。报告期内，随着产品矩阵逐步丰富及持续市场推广，精密源表、WAT 测试机的订单及出货规模均实现高速增长；
--	---

	WAT 测试机获取国内头部半导体用户批量订单，正在加速推进交付。公司是国内少数具备精密源表等核心测试部件自主能力的厂商。 13.公司如何保持技术领先优势？ 答:公司坚持“储备一代、开发一代、应用一代”的研发理念，聚焦关键技术研发；发挥以高速信号处理、微弱信号处理、超精密运动控制为核心的平台级技术体系价值，支持产品线快速升级与横向拓展；持续保持高强度研发投入；CPO 芯片测试系统、半导体综合参数分析仪等新产品线；加强知识产权管理；并通过深化全球化布局紧跟前沿技术趋势。 14.功率器件测试设备业务上半年情况？ 答:在功率器件领域，公司晶圆级老化系统、功率芯片 KGD 分选测试系统等主要面向车规级应用场景的测试设备，报告期内持续完成规模化量产交付；PB6800、WLBI3810 等新一代产品已完成客户端交付，并成功导入东芝、博世、纳微（Navitas）、中瓷电子等国内外知名用户，品牌出海持续推进。 15.公司在存储芯片测试设备这一新赛道的布局进展？ 答:公司正加速推进存储芯片测试设备的战略布局。高速存储芯片测试系统方面，自研 ASIC 芯片、PE 芯片流片成功，已通过国内头部 DRAM 厂商的 ETS 工程验证，正在进行整机验证；HBM 芯片 KGD 分选测试系统在客户处的送样验证工作有序推进；中速存储芯片测试系统研发项目已启动。相关产品处于研发验证或客户导入阶段，公司将持续推进并按规定履行披露义务。 16.公司在 CPO 等前沿测试技术方面的布局？ 答:公司全面布局 CPO 前沿测试技术，已深度布局光芯片（裸 Die/CoC）测试、硅光 PIC 芯片测试环节；面向裸 Die 级 OE 芯片测试的 OE 芯片 KGD 分选测试系统已于报告期内实现收入，并持续迭代性能，推进与国内外知名 CPO 厂商的对接合作。同时，公司拟启动高速光电混合测试 ATE 项目，已初步完成技术预研，将电学测试与光学测试集成到统一自动化测试平台。 17.公司的客户结构和市场地位如何？ 答:公司深度服务全球高速通信和半导体领域知名用户。光通信领域覆盖中际旭创、新易盛、天孚通信、东山精密、源杰科技、Lumentum、Coherent、Broadcom、日本住友、日本古河等；功率器件领域覆盖比亚迪半导体、芯联集成、士兰微、长飞先进、株洲中车、ONSEMI、东芝、博世等；半导体电性能领域覆盖比亚迪半导体、燕东微、北京电控、X-FAB 等。根据
--	---

	公开信息，2024 年公司在 中国光电子器件测试设备市场份额排名第一，在中国碳化硅功率器件晶圆级老化系统市场份额排名第一。 18.公司上半年研发投入和研发团队情况？ 答:公司始终坚持高水平、战略性、前瞻性研发投入，2026 年上半年研发投入达 2.50 亿元，同比增长 83.34%。截至 2026 年 6 月末，研发人员 624 人，占员工总数 33.37%，本科及以上学历占比 90.54%。研发投入占营收比例同比下降，主要系营收增速高于研发投入增速，研发投入金额保持高强度增长。 19.公司前五大客户占比较高，如何看待客户集中度、如何降低依赖？ 答:2026 年上半年公司对前五大客户实现营业收入 8.70 亿元，占当期营业收入 56.83%。公司主要客户均为全球行业龙头，合作关系稳定、粘性较强。公司持续拓展客户群体、丰富产品矩阵并推进全球化布局，境外收入占比已超 50%，客户结构持续优化，以分散单一客户或单一区域的依赖风险。 20.公司应收账款规模较大，回款和坏账风险如何？ 答:2026 年半年度报告期末公司应收账款账面余额 10.98 亿元，坏账准备 0.69 亿元。应收账款随销售规模增长相应增加，公司持续加强信用管理和回款管理，上半年经营现金流净额 5.48 亿元，销售回款效率显著提升。公司将持续关注应收账款质量，防范坏账风险。 21.在国产替代趋势下，公司的市场空间和相对国际厂商的竞争优势如何？ 答:公司是 国内高端测试仪器设备的头部企业，也是全球少数、国内极少数量产供货 400G/800G/1.6T 高速光模块核心测试仪器的厂商，全球第二家推出 1.6T 光模块全部核心测试仪器的厂商，多项核心产品指标达到业内领先水平，打破国际垄断、填补国内空白。相比国际厂商，公司在交付效率、本地化服务、响应速度上具备明显优势，深度受益于高端测试仪器国产化替代进程。公司将持续提升产品性能与产品线覆盖，巩固并扩大市场份额。 22.公司上市后股价涨幅较大，如何看待当前的估值和二级市场表现？ 答:公司不对二级市场股价及估值水平发表评论。公司始终聚焦主业经营与长期价值创造，经营业绩与技术创新情况以定期报告等法定披露文件为准。提醒广大投资者注意二级市场波动风险，理性投资、审慎决策。 23.公司下半年的经营重点和未来发展战略是什么？
--	--

	答:公司将继续把握 AI 产业趋势与国产替代窗口期, 聚焦光通信测试、功率器件测试、半导体电性能测试及存储芯片测试等赛道, 持续加大研发投入、推动产品性能突破与产品矩阵拓宽, 深化与全球知名用户合作, 完善全球化布局; 同时稳步推进募投项目建设, 提升研发实力与产能规模。 24.公司境外收入占比已超过一半, 海外布局和出口情况如何? 是否受贸易摩擦或汇率影响? 答:2026 年上半年公司境外收入占比稳步提升至 53.86%。公司已在新加坡、马来西亚、日本、美国、韩国、泰国等多个核心产业国家设立海外子公司, 精准覆盖东南亚、东亚、北美等核心产业区, 产品进入全球行业龙头客户供应链, 订单规模稳步增长。目前公司出口业务总体未受重大贸易摩擦影响; 针对汇率波动, 公司已开展外汇套期保值业务, 并持续保持谨慎管理以应对潜在风险。 25.公司半年度推出了每 10 股转增 4.8 股的方案, 是基于什么考虑? 答:公司披露 2026 年半年度权益分派方案, 拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数, 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.8 股, 不派发现金红利、不送红股。本次转增基于公司当前股本规模相对较小、经营业绩与资本公积增长较快的情况, 旨在优化股本结构、提升股票流动性, 更好回报投资者。该方案已经董事会审议通过, 尚需提交股东会审议后实施。 26.公司存货较年初大幅增长, 主要原因是什么? 答:截至 2026 年 6 月底, 公司存货账面价值余额 11.51 亿元, 较上年期末增长 129.85%, 主要系下游市场需求持续旺盛、核心客户产能扩张节奏加快, 公司依托充足在手订单有序开展备货。公司采取“以销定产、适当备货”的生产模式, 以订单需求为导向组织生产, 资产流动性充足, 经营风险整体可控。 27.公司如何看待所在行业的发展趋势? 答:据 SEMI 于 2026 年 7 月发布的最新年中预测, 全球半导体测试设备销售额 2026 年预计进一步增长 31%至 153 亿美元, 并有望于 2028 年达到 208 亿美元, 实现连续多年扩张; 在 AI/HP C 与先进封装需求拉动下, 测试环节持续前移, HBM 测试道数由传统 DRAM 的 3—4 道提升至 15 道以上, 测试设备需求约为传统 DRAM 的 5—6 倍。公司所在高端测试仪器设备行业受益于 AI 算力、数据中心建设、半导体国产化等趋势, 中长期成长空间广阔。
--	--

关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	本次活动不涉及未公开披露的重大信息。
附件清单（如有）	
日期	2026 年 9 月 4 日